

[꿈의 소재 유리위에 반도체를 새기다]

제이앤티씨, 유리기판 신제품 설명회 개최..."TGV유리기판 생태계 선도주자" 도약

- ▶ AI 반도체 시대 대응 위한 유리기판 핵심기술 공개 → 독자기술 내재화로 월등한 비교우위 확보
- ▶ 글로벌 반도체전문업체와 TGV유리기판 상용화 추진 → 올 하반기 베트남 대규모 양산체제 구축
- ▶ 유리기판 포함 고부가 신규 아이템 발굴 통한 미래사업 중심 체질 강화

<2025-06-30> 제이앤티씨, "TGV 유리기판 신제품 설명회" 개최, "꿈의 소재로 반도체 패러다임 전환 이끈다"

차세대 소재 선도기업 제이앤티씨(204270, 대표이사 조남혁, 장윤정)가 30일, 한국거래소 컨퍼런스홀에서 '꿈의 소재 유리위에 반도체를 새기다'는 캐치 플레이즈를 내걸고 'TGV 유리기판 신제품 설명회'를 개최했다.

이번 설명회에는 제이앤티그룹 장상욱 회장을 비롯한 주요 경영진이 참석한 가운데, 조남혁 대표이사가 TGV(Through Glass Via) 유리기판의 기술 경쟁력과 중장기 사업 전략을 직접 발표하며 제이앤티씨의 새로운 도전과 방향성을 제시했다. 이날 행사는 기자 및 투자자 등 200여 명 이상 참석했으며, 고성능 반도체용 유리기판 시장을 선도하겠다는 비전을 공유하는 자리로 마련됐다.

이번에 공개된 유리기판은 기존 플라스틱 기반 기판의 물리적 한계를 극복할 수 있는 신소재로, 고속 연산 시에 발생하는 발열 문제와 구조적 뒤틀림 문제를 현저히 줄일 수 있는 것이 특징이다. 특히 AI 및 고성능 연산 반도체에서 요구되는 정밀한 회로 구현이 가능한 높은 평탄도와 우수한 열 안정성을 갖췄다.

제이앤티씨는 올해 6월 국내에 유리기판 생산라인 구축을 완료했으며, 7월 시운전을 마친 뒤 8월부터 양산제품 생산에 착수할 계획이다. 특히 기존업체와 달리 핵심 생산설비와 장비 대부분을 자체 설계·제작함으로써 독립적 생산체제를 구축했으며, 이는 업계평균 투자비 대비 약 5분의 1 수준으로 실현된 것으로 알려졌다. 이에 따라 초기 투자 효율성과 공정 내재화 수준에서 기존업체 대비 매우 높은 경쟁력을 확보했다는 평가다.

설명회에서는 다양한 크기와 두께, 정밀한 미세 구멍(TGV 홀)을 구현할 수 있는 제품 사양도 함께 소개됐다. 제이앤티씨는 유리 특성에 맞춘 식각 및 도금, 가공 공정을 독자적으로 개발해, 균열이나 기포 없이 90% 이상 높은 수율을 달성했다고 밝혔다. 또한 패키징 공정 시 필수 사양인 기준점, Cavity를 실구현하여 글로벌 반도체 기업들과의 성능 검증을 거쳐 본격적인 수출 확대와 해외 양산거점 확보에 나설 계획이다.

제이앤티씨 조남혁 대표이사는 "TGV유리기판은 반도체 기술 발전에 따라 새롭게 떠오르는 핵심 아이템으로 당사는 이 분야 선도주자로 품질과 가격경쟁력 측면에서 월등한 비교우위를 확보했다. 이미 글로벌 반도체 전문업체 16개사와 생태계를 공동 구축하고 있는 만큼, 대규모 양산체계를 갖춰 초정밀 유리소재 글로벌 핵심기업으로 도약할 것"이라며, "이번 설명회를 계기로 국내를 넘어 글로벌 시장에서 차세대 소재 선도기업으로 자리매김하겠다"고 말했다.